



JD-727

無溶劑型矽質絕緣樹脂

UL FILE No.E526815

特點

- 100%固成分、無溶劑、低黏度。
- 濕氣硬化機制，與空氣中濕氣作用以形成彈性保護層，可採室溫硬化或加溫硬化。
- 硬化後為柔軟彈性體，具優良的絕緣、防潮及耐緩衝的特性。
- 適用於多數基材並達良好的附著性，可廣泛用於電路板或電子零件作為保護絕緣用途。
- 符合 UL94 V-0，符合 RoHS 規範。

基本物性

外觀：	半透明液體
黏度：	500 ~ 600 cps
比重：	0.95 ~ 1.05
表乾時間：@25°C	10 ~ 15分鐘(依塗層厚度而有差異)
硬化時間：	25°C x 24小時
	*若欲加溫硬化，建議： 以@60°C以下溫度並同時增加濕度(RH 55~75%)
硬度：Shore A	30 ~ 36
耐溫範圍：	-40°C ~ +200°C
玻璃轉化溫度(Tg)：	<40°C
絕緣強度：	20 kV/mm
抗張強度：	0.5 MPa
斷裂延伸率：	60%
體積電阻：	1.5×10^{14} ohm · cm
絕緣常數：1MHz	3.0
介電損耗：1MHz	4×10^{-3}
保存期限：@25°C	6個月(未開封)

注意事項

- 為獲得達到最佳的保護效果，操作前請先將基板或工件做好前處理與清潔工序。
- 與空氣濕氣接觸時，表面會開始反應結皮，然後由表面逐漸往內層硬化。硬化的速度會因為塗覆的厚度、空氣濕度與溫度受到影響。厚度越厚或是相對濕度較低，硬化所需的時間也可能因此需要延長，或是請改以加熱方式硬化。
- 開罐後，未使用完畢請密封保存，避免接觸空氣/水氣而影響保存期限。

